



三井金属

2011年6月7日

各 位

三井金属鉱業株式会社
東京都品川区大崎 1-11-1
郵便番号 141-8584

キャリア付極薄電解銅箔 Micro Thin™ のバックアップ生産体制について

当社 三井金属鉱業株式会社（本社：東京都品川区）は、主力製品であるキャリア付極薄電解銅箔 Micro Thin™ のバックアップ供給を目的とした製造ラインを当社の100%子会社である Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD. (Selangor Darul Ehsan, Malaysia.、社長：納 武士、以下マレーシア工場) 内に新たに設置することを決定しました。

この度の東日本大震災では、計画停電により、当社 特殊銅箔事業部 上尾事業所（埼玉県上尾市）の生産が一時期停止となったことから、Micro Thin™ の供給が滞り、当製品を適用するスマートフォン製造のサプライチェーン全体に多大な影響を与えてしまう事態となりました。

そこで当社は、当初、夏季に計画されていた計画停電に備え、Micro Thin™ のキャリア箔製造工程を海外拠点で、極薄箔製造工程を上尾事業所で分業できるよう準備を進めて参りましたが、当製品の社会的供給責任を重く受けとめ、BCP（事業継続計画）としてマレーシア工場内に新たな Micro Thin™ の製造ラインを設置することを決定しました。

既にマレーシア工場では汎用銅箔の設備増強を実施しておりますが、この中に Micro Thin™ の製造ラインの設置を組み入れます。

尚、このマレーシア工場への新ライン設置の目的は、当製品製造の主軸である上尾事業所のおくまでもバックアップとして機能させることであり、不測の事態が発生しない通常時は、従来通り上尾事業所での生産を継続いたします。

現在、Micro Thin™ の生産能力は上尾事業所で100万㎡/月を所持しており、これに加え、マレーシア工場にバックアップ生産能力を確保することで、旺盛な需要に安定的に対応し、サプライチェーン全体にご安心いただける供給体制を維持いたします。

記

1. 新設備の概要

製造対象製品：キャリア付極薄電解銅箔シリーズ Micro Thin™
設置場所： Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD. 内
設置の目的： 日本の拠点が稼働できない場合のバックアップ機能
供給能力： 60万㎡/月
完成予定： 2012年4月

(補足) Micro Thin™は、スマートフォン等に搭載される先端半導体パッケージ基板の主要回路形成材料として広く採用されています。

(本件お問い合わせ先) 三井金属 経営企画部広報室 TEL 03-5437-8028

以 上